

苏州国芯科技股份有限公司

2023年11月2日-6日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-018

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	交银施罗德基金；长盛基金；富国基金；利幄基金；国海证券；华福证券；上海睿华资管；国泰君安证券上海分公司；上海湘晨投资。
时间	2023年11月2日14:00；2023年11月3日10:00；2023年11月6日17:00
地点	线上网络交流及上海浦东香格里拉酒店会议室、上海国金中心会议室
上市公司参加人员姓名	证券事务代表：龚小刚先生；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>1、请介绍一下公司研发的汽车电子 PSI5 收发器专用芯片新产品的情况？</p> <p>答：公司研发的第一代汽车电子 PSI5 收发器专用芯片新产品“CIP4100B”于今年 10 月底在公司内部测试中获得成功，现已经给客户送样开发测试中。PSI5(Peripheral Sensor Interface，外围传感器接口) 接口用于将汽车传感器连接到 ECU(电子控制单元)，被广泛应用在安全气囊、底盘控制、动力总成等领域，是主要的传感器通信总线。公司成功研发的芯片新产品“CIP4100B”是基于公司高压混合信号平台研发的第一代 PSI5 收发器专用芯片，其芯片资源和配置跟国内多家一线汽车厂商做了深入沟通和调研，可以满足汽车厂商在底盘控制、动力总成和安全气囊领域的应用需求，封装形式为 QFN20L5，可实现对国外产品如 Elmos E521.4X 系列以及 ST（意法半导体）的 L9663 等相应产品的替代。CIP4100B 芯片按照汽车电子等级进行设计</p>

	<p>和生产，是继汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片研发成功之后的又一模数混合专用领域的重要芯片，在安全气囊、底盘控制、动力总成等领域有广泛应用，对公司未来汽车电子业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响，有望为解决我国汽车产业“缺芯”问题做出贡献。</p> <p>2、公司新一代汽车电子 MCU 产品“CCFC3007PT”进展怎么样？</p> <p>答：新一代汽车电子 MCU 产品“CCFC3007PT”于今年 10 月在公司内部测试中获得成功，目前，该芯片已经给客户送样并开展定点项目模组开发和测试。公司成功研发的汽车电子 MCU 新产品 CCFC3007PT 是基于公司自主 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核研发的新一代适用于汽车电子动力总成、底盘控制器、动力电池控制器以及高集成度域控制器等应用的多核 MCU 芯片，是基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的全新多核架构芯片。</p> <p>该芯片基于 40nm eFlash 工艺开发和生产，相对于同系列的 CCFC3008PT 芯片，通信 LIN 增加到 16 路、MCAN 增加到 12 路，芯片的存储空间 Flash 容量增加到 12M 字节，数据存储最高配置 Flash 最高可达 512K 字节，内存空间 SRAM 增加到 1536K 字节。另外，该芯片优化了 SDADC 模块及相应的数字滤波模块，使其更适合电机控制，还增加了 I2S（2 路）用于连接音频设备；CCFC3007PT 芯片按照汽车电子 Grade1 等级、信息安全 Evita-Full 等级、功能安全 ASIL-D 等级进行设计和生产，具备高可靠性和高安全性，可以应用于苛刻的使用场景，从而增加了产品的应用覆盖面，封装形式包括 BGA416/BGA292/LQFP216 等，可以广泛应用于汽车动力总成、底盘控制、动力电池控制器和高集成度的域控制器。</p> <p>3、公司体内是否包含有国家级专精特新“小巨人”企业？</p> <p>答：公司的全资子公司天津国芯科技有限公司为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 11 月